

檔 號：
保存年限：

國立清華大學 函

地址：新竹市光復路2段101號
承辦人：呂瑄宜
電話：5715131#33756
傳真：
電子信箱：lu2@mx.nthu.edu.tw

受文者：國立暨南國際大學

發文日期：中華民國115年4月22日
發文字號：清動字第1159003165號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：徵求.png (115EJ00488_1_22134532532.png)

主旨：檢送本校辦理有關「ASME Journal of Electronic Packaging (JEP)」徵稿啟事1份，請公告周知，並協助轉知所屬踴躍投稿。

說明：

- 一、本次徵件主題：Reliability of 3D IC packaging: Recent Progresses in Analysis, Simulation and Experimental Methodology。
- 二、相關徵求說明請參閱網址：<https://reurl.cc/vEaMNL>。

正本：各公私立大專校院

副本：

